

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

| | |
|------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 会议主题 | 上海合晶 2025 年及 2026 年一季度业绩交流电话会 |
| 参与单位名称 | 中信证券、高盛资管、Flow Traders、光大保德信基金、由榕资产、光大自营、东方基金、淡水泉投资、财通基金、人保资产、太平资产、大家资产、北京国际信托、兴业基金、源乘投资、红土创新、国新投资、富荣基金、上海保银投资、仁桥资产、美阳投资、英大保险资管、重阳战略投资、睿远基金、致顺投资、四川发展基金、泾溪投资、中华联合保险集团、海之源投资、南银理财、青鼎资产、宏鼎财富、百川投资、国华兴益资产、健顺投资、乾惕投资、恒邦兆丰资管、途灵投资、乾弘久盛资管、闻天投资、禹田资本、万向创投、首创证券、中原证券、丹寅投资、益和源资产、浙江伟星资产、深圳向日葵投资、英轩捷信投资、天风证券 |
| 时间 | 2026 年 6 月 9 日 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 执行董事、总经理 陈建纲 首席技术官 李文中 财务总监 方时彬 |

| | |
|----------------------|---|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>一、公司 2025 年及 2026 年一季度业绩情况</p> <p>2025 年公司实现营业收入 13.11 亿元，较上年同期的 11.09 亿元增长 18.27%；归属母公司所有者的净利润 1.25 亿元，较上年同期的 1.21 亿元增长 3.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.17 亿元，较上年同期的 1.08 亿元增长 8.53%。</p> <p>在半导体行业景气度持续复苏，国产化替代加速以及下游晶圆厂产能扩张的背景下，公司的下游客户库存水位回归合理，产品销量增加，产能利用率维持高位，带动收入和净利润的上升。受益于功率器件和模拟芯片下游需求回暖，外延片需求重回增长态势。一方面，公司积极布局 12 英寸大尺寸硅片的研发与建厂扩产，12 英寸客户需求增加带动销量提升，收入和利润同比增长。另一方面，公司 8 英寸产品差异化策略进一步落实，推动功率器件领域外延片高端国产化替代。2025 年公司产品折 8 英寸销量提升 22.96%，8 英寸和 12 英寸产品销量同比实现增长，其中 12 英寸产品销量增幅较大，同比去年报告期增长 83.03%。</p> <p>2026 年一季度公司实现营业收入 2.80 亿元，相比于去年同期减少 0.04%，营业收入基本持平；归属于上市公司股东的净利润 1255.06 万元，相比于去年同期减少 34.66%，利润下滑的主要原因是财务费用的大幅增加，货币资金因募投项目投入而减少，导致利息收入同比大幅下降，以及汇率变动造成的汇兑损失增加。但是公司 2026 年一季度的毛利率从 2025 年一季度的 23.53%提升至 28.14%，增长了 4.61 个百分点，说明了公司产品或成本结构在 2026 年一季度得到了优化，单位产品的盈利空间扩大，主营业务的盈利能力有所提升，以及公司在成本控制能力上具备较强的韧性。</p> <p>二、2026 年业务布局介绍</p> |
|----------------------|---|

公司推进郑州合晶二期 12 英寸扩产项目，战略投资设立 SOI 合资公司，进一步夯实其技术壁垒与市场竞争力。

郑州合晶二期 12 英寸半导体硅片扩产项目稳步推进，规划新增外延片产能 72 万片/年。项目达产后，公司 12 英寸一体化外延总产能将提升至 120 万片/年，成为营收增长主引擎。二期项目聚焦 CIS 图像传感器、逻辑芯片等高端应用，产品已通过关键客户中小批量验证，为后续大规模量产奠定基础。在半导体产业链自主可控趋势下，公司 12 英寸产能释放将精准对接国内晶圆厂需求，加速替代进口产品。

公司进行战略升级，布局 SOI 合资公司，切入高附加值赛道。该布局将助力公司打破海外垄断，抢占国产替代与新兴应用增量市场。公司设立 SOI（绝缘体上硅）合资公司，将切入技术壁垒高、利润空间大的 SOI 硅片领域。SOI 项目公司与郑州合晶二期扩产项目形成协同合作，强化公司在高端半导体材料领域的垂直整合能力，提升产品附加值与客户粘性。

三、问答交流环节

问题 1：请问公司的经营层对 2026 年的半导体行业景气度怎样判断？

答复：就全球半导体硅片行业，受 AI 应用拓展，2025 年走出下行周期，预计 2026 年整体向上，12 英寸硅片市场持续扩容，对市场持乐观态度；就国内半导体硅片行业，基于国产化替代进一步加速需求，2026 年下半年给高端国产化替代及产品差异化竞争带来更大机会。

问题 2：请问公司对半导体硅片的价格怎么看？

答复：2025 年半导体硅片走出下行周期，全球出货量反弹但价格仍在底部，今年海外市场的确存在涨价，上海合晶也有海外市场。目前国内国产化替代需求增加，上海

合晶进行高端国产化替代，通过产品差异化竞争、优化产品组合来获得更好的利润。

问题 3：请问公司 12 英寸产品领域的产能及规划怎么样？

答复：子公司上海晶盟现有 12 英寸外延片产能为 48 万片/年；为进一步做大 12 英寸产品，子公司郑州合晶建设 12 英寸半导体大硅片产业化项目，规划新增 72 万片/年 12 英寸外延片产能，郑州合晶 12 英寸大硅片研发暨产业化项目 2026 年 6 月产线启用，后续产能将逐步释放；上海合晶不仅仅是 12 英寸 more epi，还有 more than epi 规划。上海合晶计划落地 12 英寸 SOI 晶圆项目。项目落地郑州，可以与当地郑州合晶二期项目协同合作，可有效分摊高昂的基础设施和运营成本，显著降低初期投资与运营成本。分三期建设，最终实现 216,000 片年产能。

问题 4：上海合晶的毛利率在同行业中表现较好，请问原因是什么？

答复：1) 产品差异化优势：公司聚焦高端产品，透过高度客制化产品销售策略实现高毛利率。

2) 境外客户溢价：公司向全球前十大晶圆代工厂中的 7 家以及全球前 10 大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货，如华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、安森美等。与国际大厂做生意相对毛利率高。

3) 分步投资策略：子公司上海晶盟 2005 年成立，基本折旧完成；郑州合晶一期 2018 年底建设成功，预计 2028 年基本折旧完成。郑州二期 12 英寸大硅片研发暨产业化项目 2026 年 6 月产线启用，后续产能将逐步释放，上海晶盟（基本折旧完毕）与郑州一期即将释放的折旧红利，将与 2026 年建成的郑州二期形成战略协同，利用前期产线基本折旧完毕的优势支持新产线初期爬量阶段的成本。

4) 有效内部管理：透过供应商精细化管理，采购成本控管，物料替代优化，以及损耗控管良率提升，实现高毛利率。

问题 5：CIS 领域的发展趋势是什么？和 AI 有哪些关联？

答复：全球 CIS 市场与技术的领导者是日本的索尼，索尼对 CIS 的发展蓝图已推进至第五代。从第二代起，除了影像检测外，还加入了影像信号处理的功能，做法是将第一代的 CIS (FSI 及 BSI)，再加上逻辑器件与存储器件，以垂直堆叠的方式，构成先进 CIS 的多层结构。

先进 CIS 的多层结构是将 CIS (BSI) 以 P/P+ (重掺硼衬底上生长轻掺硼外延) 作为 CIS 影像检测的光学与光电结构，这部分和第一代 CIS 基本相同。完成影像检测结构后，还要再加上逻辑电路，这部分就要由 FD-SOI 制作，之后再加上存储器件，以实现影像信号处理的功能。这种先进 CIS 结合 AI 的边缘运算，将大量应用于智能载具，例如配备 ADAS (先进驾驶辅助系统) 的自动驾驶汽车和无人机，在这一领域的应用方面，中国拥有国际领先的市场契机，但国内的 CIS 大多仍属于第一代的 BSI-CIS 甚至是 FSI-CIS。

上述先进 CIS 所需的 P/P+ 及 FD-SOI，其中的核心技术有三项：重掺长晶与晶片技术 (重掺硼衬底)、超高纯度外延技术 (轻掺硼外延)、SOI 晶片技术 (FD-SOI)。当然，这三项技术都是 12 英寸的。

上海合晶擅长前两项技术，且在国内外市场有多年的实绩，第三项的 SOI 也已开发成功，并将在国内建厂投入量产。上海合晶熟悉 CIS 产业的发展并洞悉其技术蓝图，针对先进 CIS 结合 AI 的中国优势市场所需的各类芯片，善

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>用自身技术优势并及早布局，将助力中国智能载具的快速发展，扮演先进 CIS 结合 AI 的芯片完整方案提供者。</p> <p>问题 6: 请问目前公司的科创债与定增进度如何?</p> <p>答复: 科创债于 2026 年 4 月底已拿到批文，拟募集资金总额不超过人民币 6 亿元，用于郑州合晶 12 英寸半导体大硅片产业化项目，实际发行进程将配合公司资金状况、财务成本效益等因素择机发行。</p> <p>定增项目自公司 2026 年 3 月董事会后启动，募集资金总额不超过人民币 9 亿元，用于郑州合晶 12 英寸半导体大硅片产业化项目及补充流动资金，目前为申报材料准备阶段。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p> | <p>不涉及。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | |